

財政統計通報

(第 11 號)



財政部統計處

108 年 6 月 13 日

撰稿人：李震宇研究員

聯絡人：梁冠璇科長

聯絡電話：(02)23228341

我國生產半導體等機械出口連續 6 年創新高，且為今年前 5 月唯一增長之主要機械品項

1. 我國半導體產業自首家美商來台投資電晶體封裝起，已歷經約半個世紀，如今在 IC 設計、晶圓代工及封測等方面，均在全球占有重要地位，惟半導體製程設備之自製率仍低。國內生產半導體等機械出口於 95 年突破 10 億美元，除 98 年金融海嘯外，之後至 105 年之 10 年間多在 10 多億美元間徘徊，占總出口 0.4% 至 0.6%，106 年因中國大陸積極扶植半導體產業發展並大舉興建晶圓廠，加上國內廠商在彼岸設廠而機器設備復出口¹增加，我國生產半導體等機械出口躍升至 28 億美元，較 105 年增逾 6 成，占總出口 0.9%，107 年出口值 31 億美元再創新高，108 年 1-5 月為 13 億美元，占總出口比重升抵 1.0%，占機械出口 1 成 3，亦是唯一正成長(年增 3.8%)的主要機械細項。出口市場集中於陸港，近 2 年約占 5 成，美、日、韓、星等國則多在 1 成上下。

我國生產半導體等機械出、進口金額及年增率

單位：億美元；%

	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年 1-5月
出 口														
金額	12.2	11.5	12.8	4.8	9.6	12.0	11.2	13.3	14.6	14.9	17.3	28.1	31.3	13.3
年增率	27.4	-6.2	11.3	-62.2	98.6	24.7	-6.1	18.7	9.4	2.0	16.0	62.7	11.5	3.8
進 口														
金額	102.5	114.1	84.4	60.6	130.9	106.5	100.9	119.4	102.1	104.5	141.2	124.7	116.9	65.2
年增率	16.0	11.3	-26.0	-28.2	115.9	-18.6	-5.3	18.4	-14.5	2.3	35.1	-11.7	-6.2	35.0

2. 由於我國半導體設備製造產業發展之起步較晚，相對於出口以中低階製程設備及零件為主，進口則多屬先進製程者，於 93 年即突破 100 億美元，105 年 141 億美元為歷史高點，106 及 107 年走勢下滑，108 年 1-5 月進口 65 億美元(年增 35%)，又創同期高峰，以自日本、美國及荷蘭進口較多，三者合占 7 成 7。進、出口對照比較，100 年生產半導體等機械出口值為進口規模之 1 成 1，之後雖有提升，107 年最佳時亦僅及進口之 2 成 7，差距仍大，國內產業仍需持續精進，以提高設備自給率及拓展更大外銷份額。

我國生產半導體等機械出、進口國家/地區概況

單位：億美元；%

年(月)別	出口地區					進口來源			
	中國大陸 與香港	美國	日本	南韓	新加坡	日本	美國	荷蘭	新加坡
金額									
100年	5.2	1.7	1.8	1.1	0.7	38.7	25.5	17.9	8.3
106年	15.6	3.3	2.0	2.8	2.0	38.1	35.2	20.0	17.9
107年	14.8	4.5	2.9	3.2	2.2	34.1	29.3	22.6	12.7
108年1-5月	6.5	1.6	1.2	1.2	1.2	19.5	15.5	15.1	7.0
占比									
100年	43.2	14.2	14.9	9.5	6.1	36.3	23.9	16.8	7.8
108年1-5月	48.9	12.1	9.0	9.0	8.7	29.9	23.8	23.1	10.8
年增率									
100年	54.6	2.7	49.2	-35.0	20.6	-21.8	-32.3	-11.1	32.8
106年	123.3	30.0	-9.0	11.8	73.3	-21.0	2.1	-26.7	-1.0
107年	-4.8	39.3	47.7	15.2	13.2	-10.3	-16.8	13.0	-29.3
108年1-5月	3.3	-13.9	5.5	-6.1	34.9	30.3	20.8	116.3	16.6

資料說明：生產半導體等機械係指 HS code 8486。

¹ 係指國內廠商將原購自外國之機械設備復運至中國大陸之狀況。